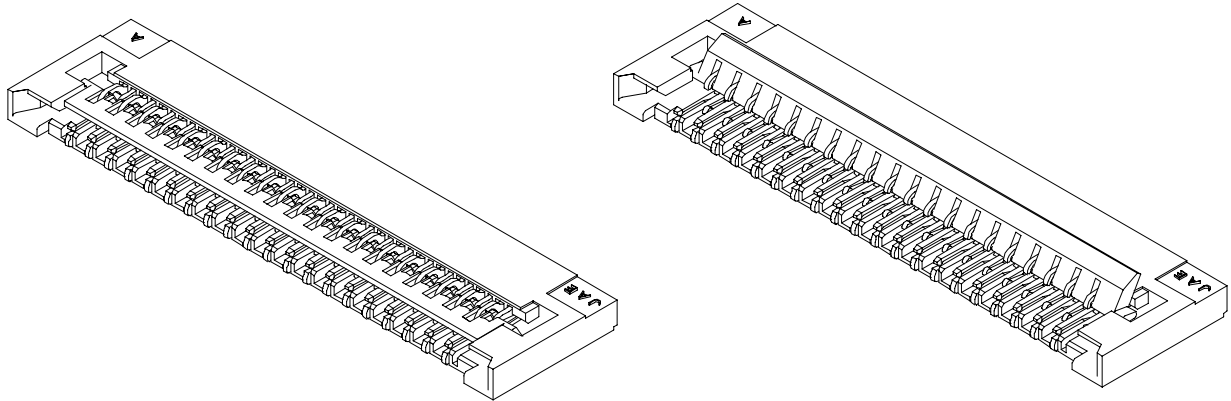


NEW

0.3mmピッチ FPC用コネクタ  
FF02SシリーズCONNECTOR  
MB-0146-2  
2006/07

RoHS対応品



## 《概要》

携帯電話、液晶ディスプレイ、PDAをはじめとする情報通信関連機器の小型化、薄型化に対応する耐落下衝撃 / 振動対応 0.3mmピッチFPC接続用ロープロファイルコネクタです。

## 特 長

- コネクタ高さ 0.9mm、奥行き 3.8mmの小型・低背型
- アクチュエータ 一体型カムが全てのコンタクト接触部でFPCを押さえつける独自の構造で多極でも確実な嵌合が可能
- Pbフリー対応（コンタクトにニッケルバリアを施し半田上がりを防止）

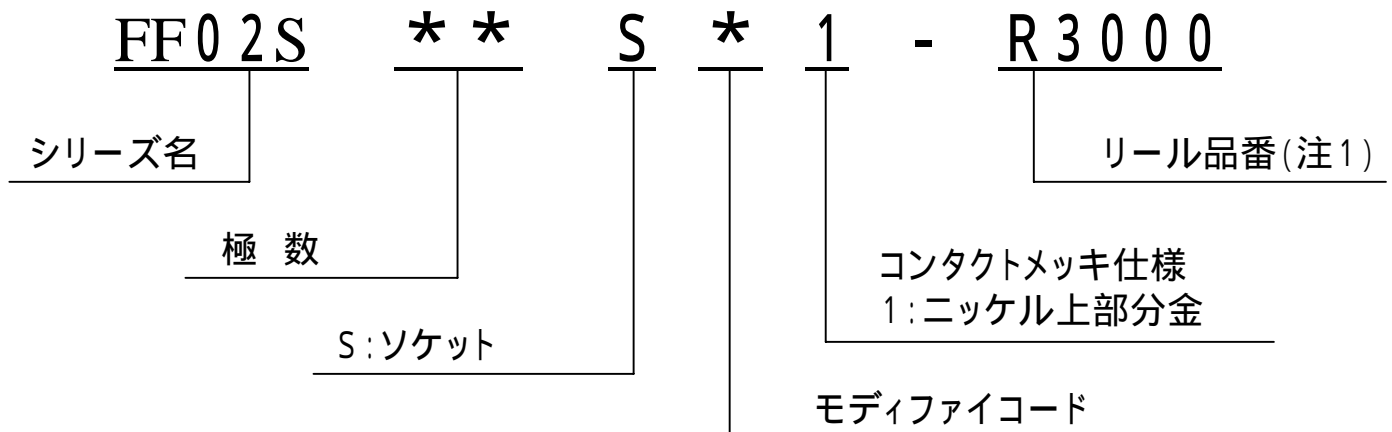
## 一 般 仕 様

- |       |  |         |                       |
|-------|--|---------|-----------------------|
| ■極数   | : 25、31、33、40、45、55、<br>(15、17、27、29、35、60、<br>65、) ( )内は計画中 | ■接触抵抗   | : 40mΩ 以下             |
| ■定格電流 | : AC、DC各0.35A/1端子当り  | ■絶縁抵抗   | : 100MΩ 以上            |
| ■定格電圧 | : AC、DC 50V  | ■耐電圧    | : AC250Vr.m.s 1分間     |
| ■使用温度 | : -40 ~ +85  | ■適合FPC厚 | : $t = 0.12 \pm 0.03$ |

## 材料・仕上

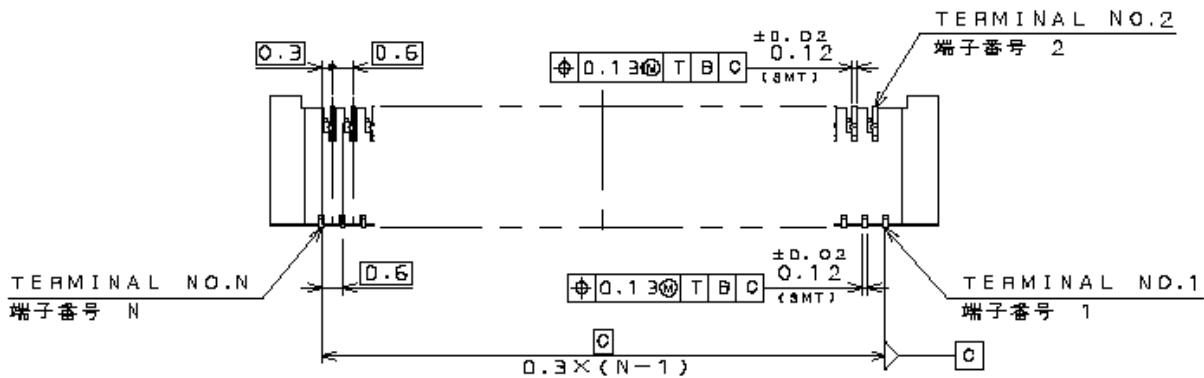
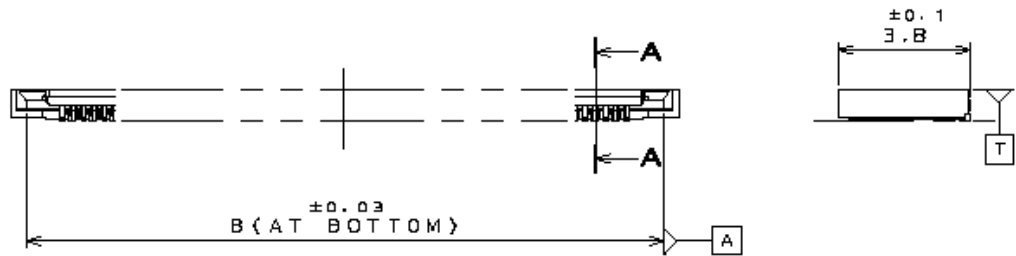
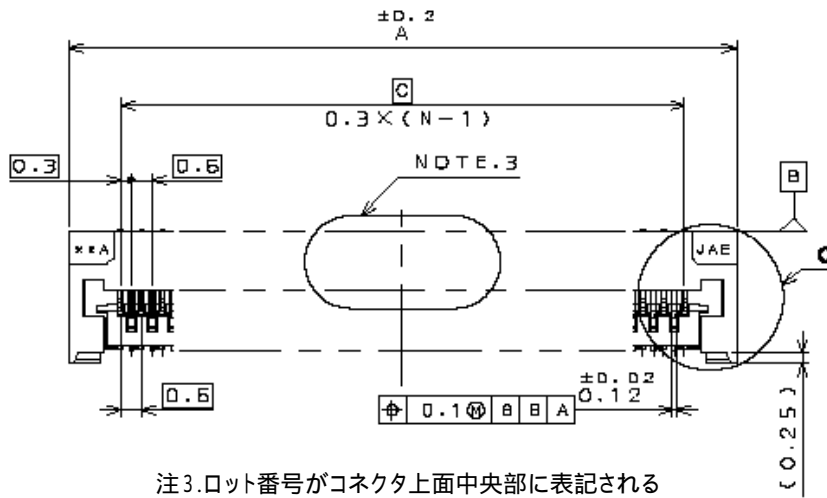
構成部品	材料/仕上
アクチュエータ	PPS (UL94V - 0・色相：黒)
ベースインシュレータ	LCP (UL94V - 0・色相：白)
コンタクト	銅合金/ニッケル上部分金 接触部：Au0.1 μm以上 端子部：Au0.03 μm以上

## 品名構成



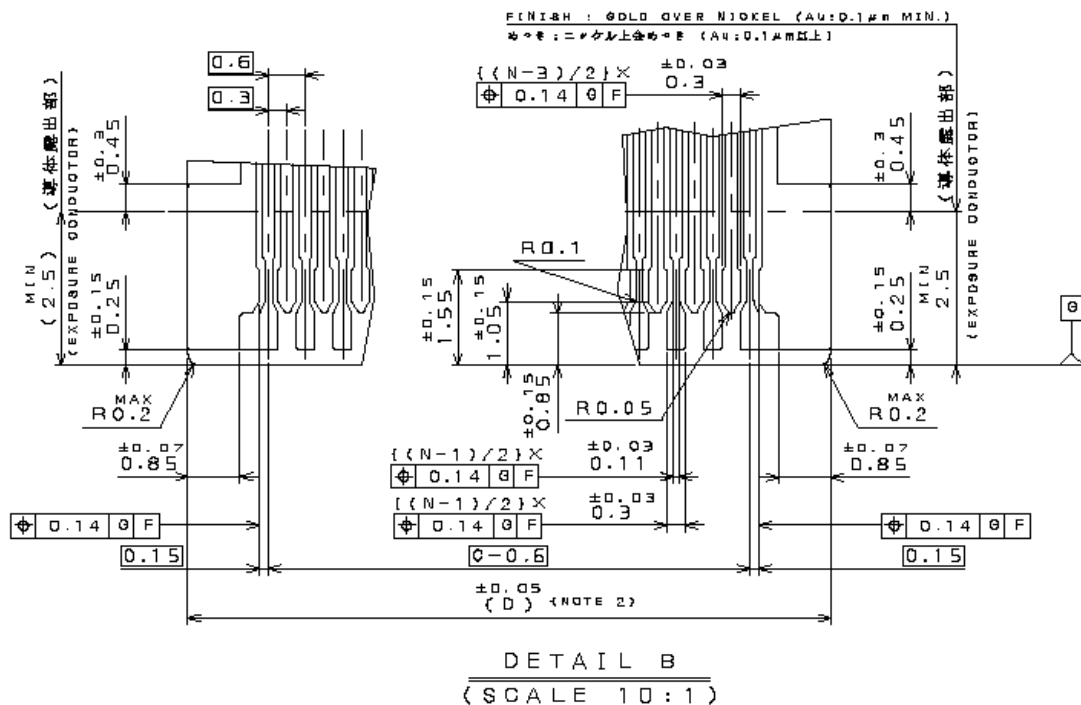
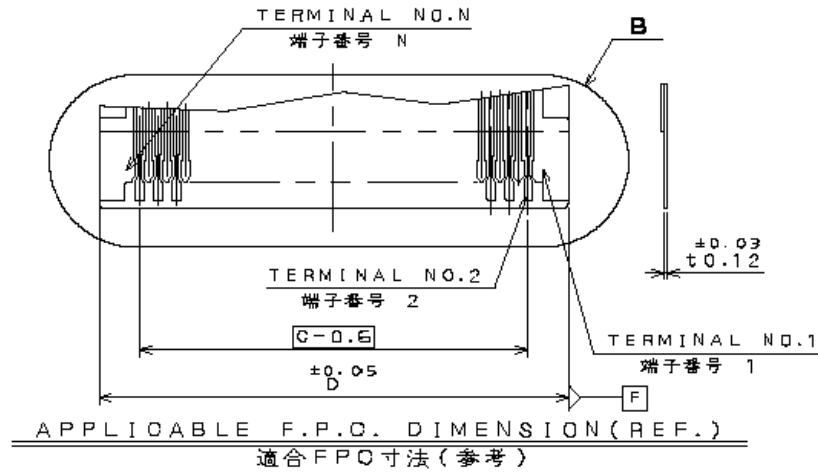
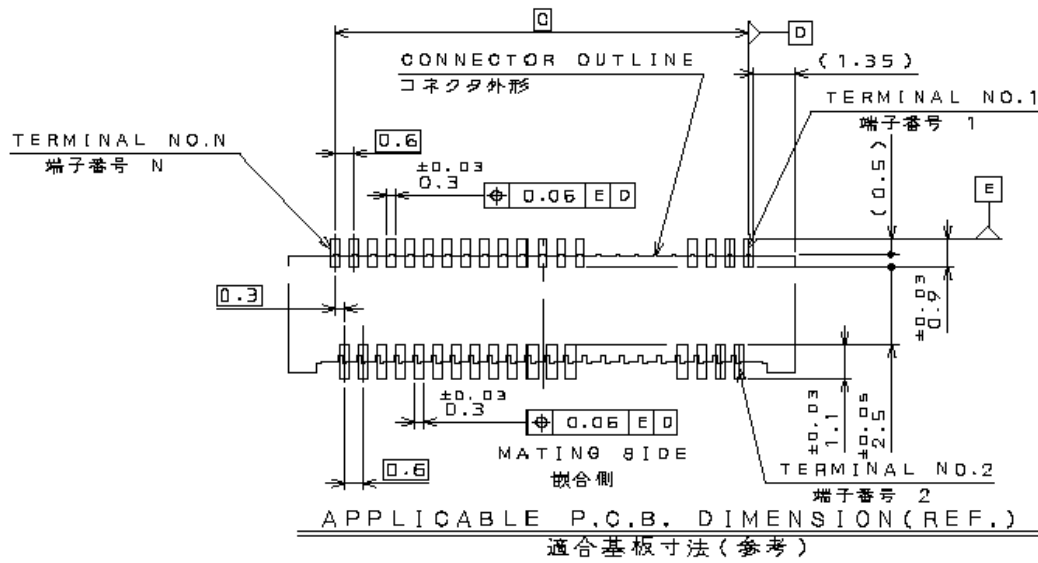
注1:エンボス梱包は、3000個/リールです。  
エンボステーピング仕様については別途お問い合わせ下さい。

**【奇数芯数】**



PRODUCT 品名	A	B	C	D
FF02S65SV1	22.2	21.31	19.2	21.24
FF02S55SV1	19.2	18.31	16.2	18.24
FF02S45SV1	16.2	15.31	13.2	15.24
FF02S35SV1	13.2	12.31	10.2	12.24
FF02S33SV1	12.6	11.71	9.6	11.64
FF02S31SV1	12.0	11.11	9.0	11.04
FF02S29SV1	11.4	10.51	8.4	10.44
FF02S27SV1	10.8	9.91	7.8	9.84
FF02S25SV1	10.2	9.31	7.2	9.24
FF02S17SV1	7.8	6.91	4.8	6.84
FF02S15SV1	7.2	6.31	4.2	6.24

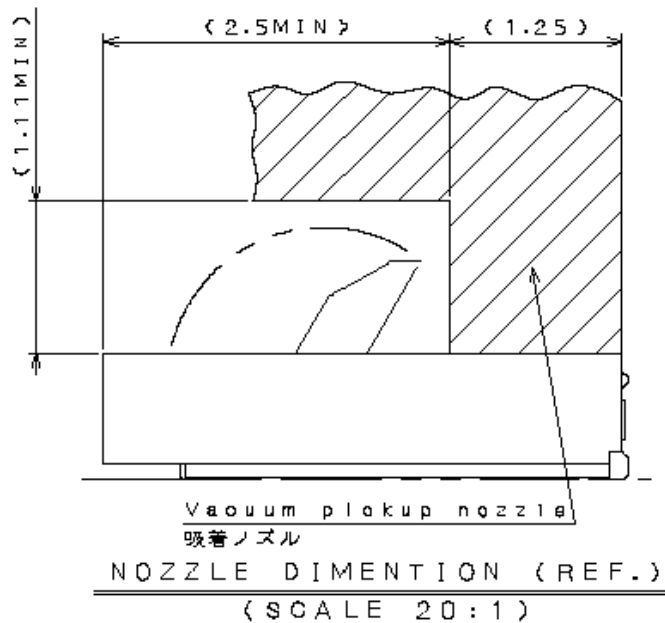
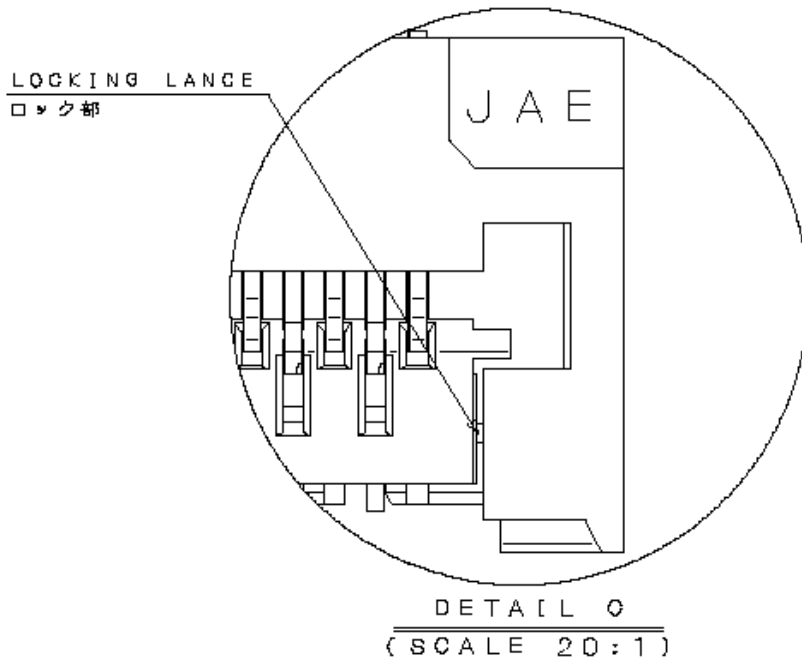
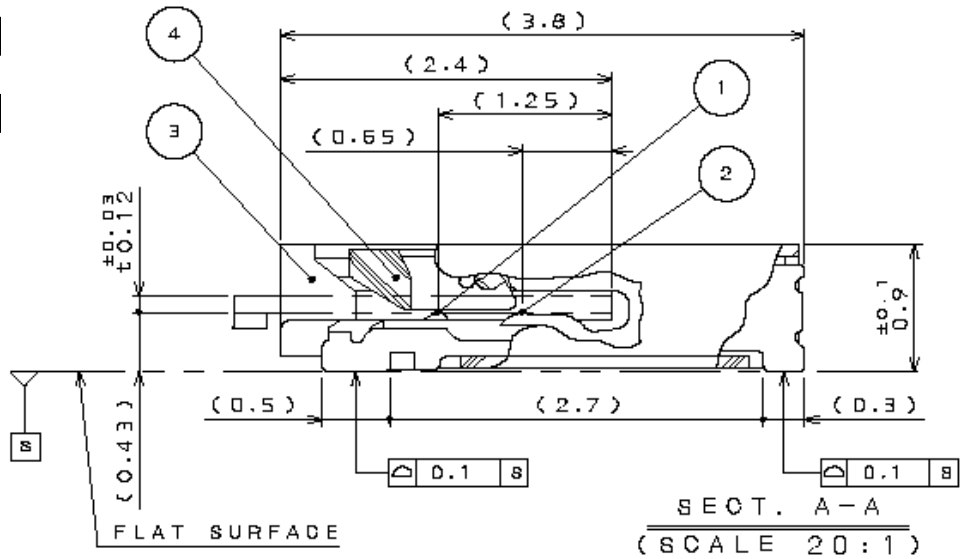
**【奇数芯数】**



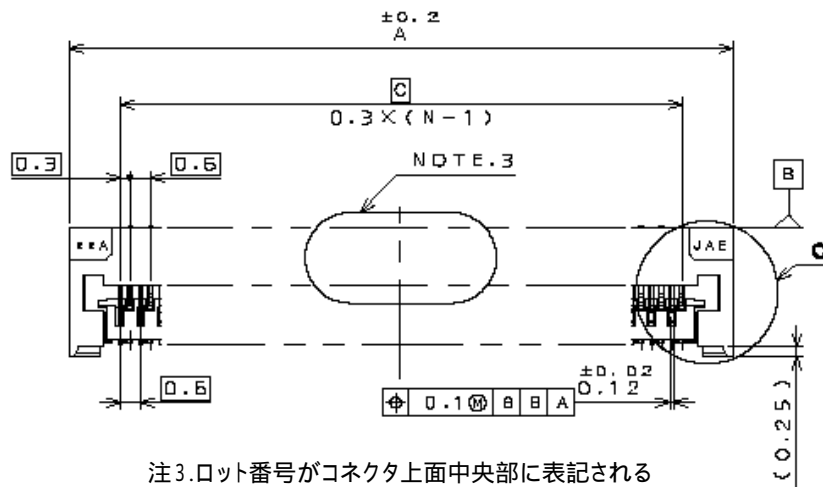
注2. 寸法Dはピッチ方向の位置決め精度を高め接触信頼性を高める為に +0.05 - 0.01を推奨する

【奇数芯数】

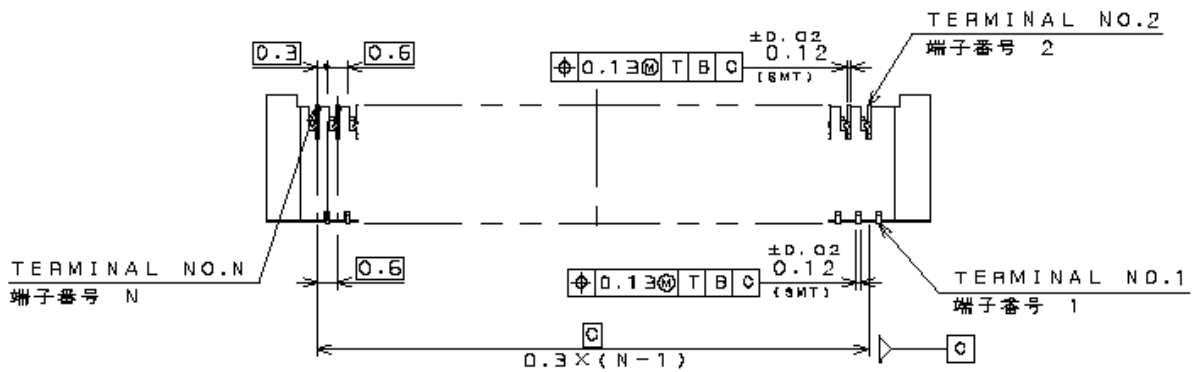
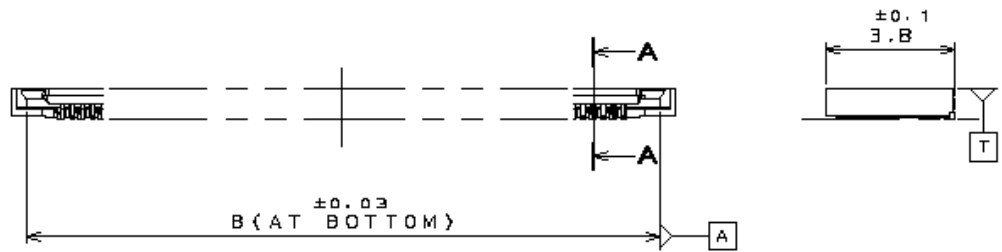
【偶数芯数】



**【偶数芯数】**

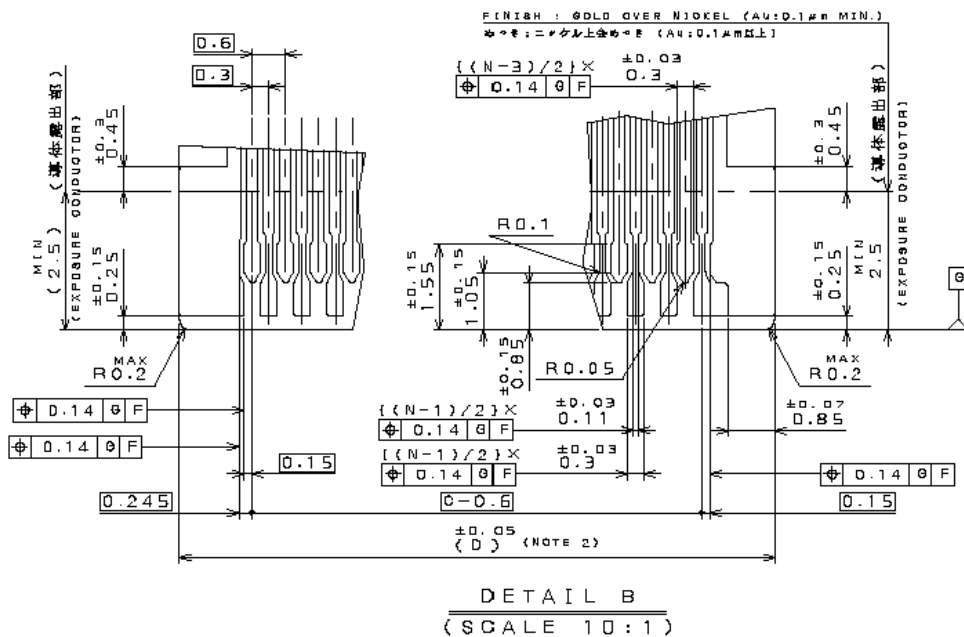
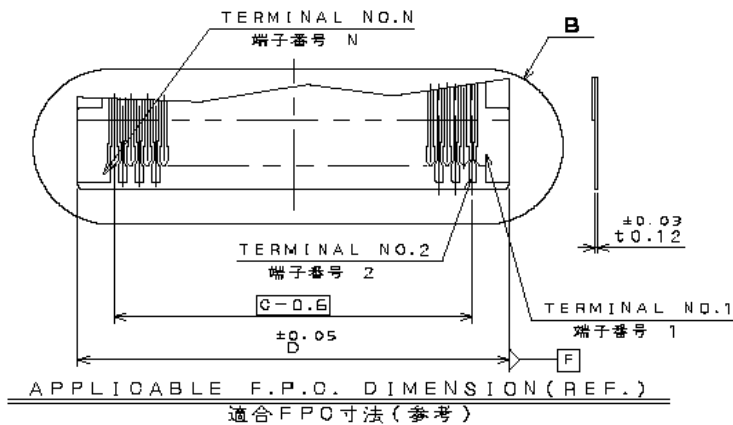
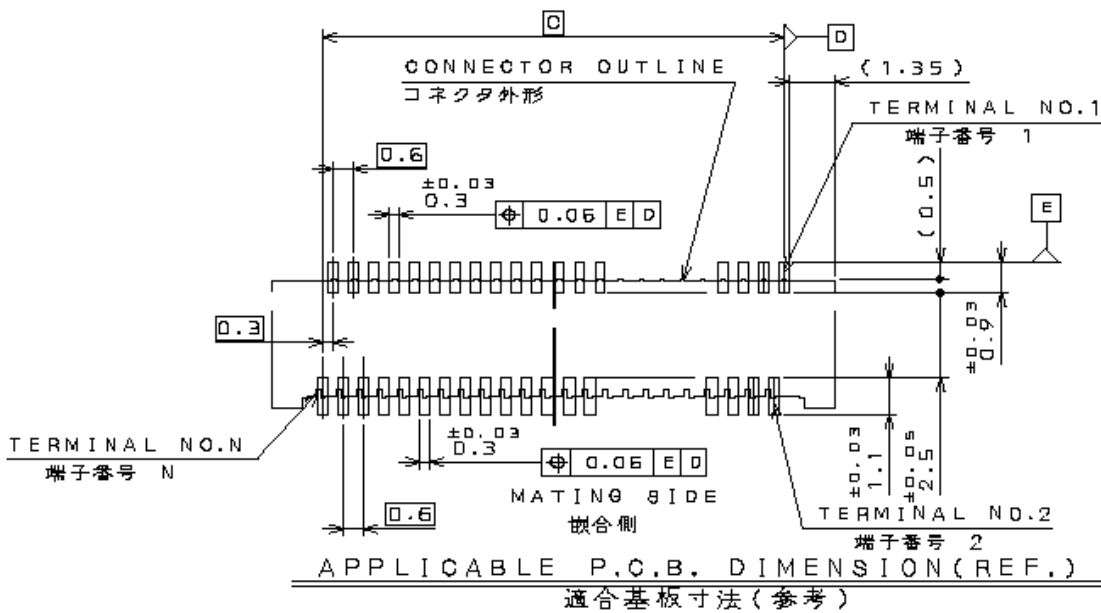


注3.ロット番号がコネクタ上面中央部に表記される



PRODUCT 品名	A	B	C	D
FF02S60SV1	20.7	19.81	17.7	19.74
FF02S50SV1	17.7	16.81	14.7	16.74
FF02S40SV1	14.7	13.81	11.7	13.74

**【偶数芯数】**



注2.寸法Dはピッチ方向の位置決め精度を高め接触信頼性を高める為に +0.05 - 0.01を推奨する

## FPC構成(推奨)

COMPOSITION 層名		RECOMMENDED 推奨
GOLD PLATING 金メッキ	ELECTROLYSIS PLATING 電解メッキ	0.1 μm MIN
NICKEL PLATING ニッケルメッキ	ELECTROLYSIS PLATING 電解メッキ	SOFT TYPE IF AVAILABLE
COPPER 銅箔	ROLLED MATERIL 圧延銅	NOMINAL 18 μm MAX
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性	NONE (RECOMMENDED)
BASE FILM ベースフィルム	POLYIMIDE ポリイミド	25 μm
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性	30 μm MAX
REINFORCE PLANTE 補強板	POLYIMIDE ポリイミド	—————

仕様書 SPECIFICATION	
製品図面 Drawing	SJ104079(奇数) SJ104400(偶数)
製品規格表 Specification Table	JACS - 10293
製品取扱い説明書 Operating Manual	JAHL - 10293

(注) 仕様書類は必ずご請求願います

## ご注文に際してのお願い

本カタログ記載の製品は、下記の推奨用途に使用されることを意図しております。従い、推奨用途以外へのご使用又は「航空宇宙機器」、「海底中継器」、「原子力制御システム」、「生命維持のための医療機器」などの極めて高信頼性が要求される特定用途へのご使用をお考えの場合は、必ず事前に当社販売窓口までご相談下さいますようお願い申し上げます。

推奨用途例 : 電算機、事務機、計測機器、通信機器(端末、移動体)、AV機器、家電、FA機器、等。

 日本航空電子工業 株式会社

プロダクトマーケティング本部

〒153-8539 東京都目黒区青葉台 3-1-19 (青葉台ビル)

TEL : 03-3780-2787 FAX : 03-3780-2946

改良の為、予告なく形状・仕様等変更することがあります。ご検討の際はお問合せ下さい。